高通或将退出服务器芯片市场 英特尔垄断地位难撼动？

本报记者 顾鸿儒

高通或将退出服务器芯片市场，其服务器相关部门可能会被售卖或关闭。5月8日，彭博社援引知情人士消息称，全球最大的手机芯片制造商高通准备放弃开发数据中心服务器芯片，该知情人士还表示，高通正考虑关闭还是售卖这一业务。

高通放弃服务器芯片存疑

高通若能分食该市场一点点的份额，有助于分散其终端市场的经营风险。

作为全世界占据主导地位的手机应用处理器制造商，高通在手机处理器领域取得了不错的成果，而在服务器芯片领域，高通想借由英特尔的竞争对手Arm的技术产品，打破英特尔在这个利润丰厚市场的主导地位。2017年11月8日，高通发布了全球首款也是唯一的10纳米服务器处理器系列Qualcomm Centriq 2400，并宣布商用出货，该系列产品首次尝试在服务器中采用Arm的技术产品。

然而，六个月后，却传来高通或将售卖服务器业务的消息，此举与高通总裁德雷克·阿伯尔此前所表示的信息完全相反。雷克·阿伯尔曾公开表示，高通计划向服务器芯片市场进行足够多的投资，并预计需要较长时间才能获得投资回报。他说：“在我们看到回报之前，可能需要多年的大笔投资。我们认为，只有少数公司有能力涉足这一市场并取得成功，而我们是其中之一。”

目前高通官方并没有否认这一消息。IHS首席分析师何晖表示，高通不会在不熟悉的领域付出太多精力。“服务器对于高通来说并不是熟悉的领域，高通也是新玩家。包括高通在内的很多大公司，都不会将太多的精力放在不太擅长的领域。例如Intel，之前也曾计划向自己不擅长的手机领域进军，最后也没有投入太多精力。对于高通来说，5G才是重点。”何晖说。

何晖向记者解释，高通当初决定进军服务器领域，还存在着其他方面的因素，因为服务器应用面对的都是大型化市场。“高通与贵州省人民政府合资生产服务器芯片，贵州提供场地，高通提供技术支持。因为进军服务器领域，除了技术之外，努力争取大型化工业业务也十分重要。”何晖对《中国电子报》记者说。

但是集邦拓墣产业研究院分析师姚嘉洋却对“高通放弃服务器”这条消息表示怀疑。姚嘉洋向记者表示，高通不太可能放弃服务器市场。

“基本上，在高通官方仍未正式发布放弃此一业务之前，我们认为高通应不至于这么快就放弃该市场。目前服务器市场仍然是处于成长的状况，英特尔最新一季的财报，服务器部门营收非常亮眼，高通若能分食该市场一点点的份额，有助于分散其终端市场的经营风险。”姚嘉洋说。

但是高通最近频繁的裁员动作，令人怀疑其进军服务器领域的决心。“在IoT、服务器部门，高通最近裁员比较多。”何晖说。

x86的生态体系更为成熟

Intel的x86对整个服务器领域具备着很高的适应性，生态要成熟得多。

Centriq 2400的发布会上，高通表示，与英特尔性能最高的Sky-lake处理器——英特尔至强铂金8180相比，搭载Arm技术产品、定价为1995美元的48核Qualcomm Centriq 2400处理器可提供4倍以上的性价比，并提升性瓦比高达45%。

谷歌平台副总裁Bart Sano公开表示，Centriq 2400将会使得数据中心处理器设计领域出现新的选择，数据中心设计已然可以选择64位Arm v8-A架构和生态系统。微软Azure基础架构与管理副总裁Mike Neil也表示，Centriq 2400非常适合超大规模云中高度并行的工作负载，并期待其提供非常领先的性瓦比。

在期待值如此高的情况下，如果高通真的放弃进军服务器领域，对Arm来说，可能失去了一个很好的机会。“目前服务器领域百分之九十都是英特尔的市场，Intel近期的财报也表示，其大部分的获利来自服务器领域。”何晖说。

姚嘉洋也十分看好服务器市场。“事实上，服务器市场的生态相较于智能型手机来说，其替换的周期较长，需要相当完整且成熟的生态系统来支撑，这一点，英特尔远比Arm阵营优异。”姚嘉洋说。

何晖同样表示，成熟的生态系统是Intel的一大优势。“Intel的x86对整个服务器领域具备着很高的适应性，其x86是自己在做，与Arm相比，Intel的生态要成熟得多。”何晖说。

作为英特尔的唯一竞争对手，Arm除了成熟的生态系统，所面临的挑战有很多。“我们并不会说Arm完全没有机会，只要云端服务供应商（CSP），如GOOGLE或是FB等，在营运服务等相关系统皆有一定的稳定度之下，适量且适当地采用Arm架构的芯片方案，是有可能发生的。毕竟，Arm在低功耗方面的表现仍然相当出色，CSP厂商也要考量到营运成本（如电费）的因素。”姚嘉洋说。

此次传出来的“高通放弃服务器市场”的消息尚未落实，但是即使高通真的不打算为服务器市场付出更多的精力，也不代表着Arm的架构要次于Intel。“因为这项选择与高通内部业务调整和产品调整分离不开，Arm只是IP的供应商，还要看产品是谁在用。例如海思、高通等公司都在使用Arm的开源技术，因此优化技术也存在差异。”何晖说。

Arm Artisan物理IP将应用于台积电22nm ULP/ULL平台

本报讯 5月7日，Arm宣布旗下Arm Artisan物理IP将应用于台积电基于Arm架构的SoC设计22nm超低功耗（ULP）和超低漏电（ULL）平台。台积电22nmULP/ULL技术针对主流移动和物联网设备进行了优化，与上一代台积电28nm HPC+平台相比，在提升基于Arm的SoC性能的同时，更显著降低功耗和硅片面积。

“本次发布的下一代工艺技术能够以更低的功耗、在更小的面积上满足更多的功能需求。”Arm物理设计事业群总经理Gus Yeung指出，“Artisan物理IP与台积电22nmULP/ULL技术的设计和制造成本优势相结合，将为我们双方的合作伙伴带来立竿见影的每毫瓦运算性能提升及硅片面积缩减两方面优势。”

针对台积电22nmULP/ULL工艺技术推出的Artisan物理IP，包含了代工厂支持的内存编译器，对下一代边缘计算设备的低泄漏和低功耗要求进行了优化。除此之外，这些编译器还附有超高密度和高性能的物理IP标准单元库，其中含有电源管理套件和厚栅氧化物元件库，以协助优化低泄漏功耗。另外，最新的物理IP还提供了通用I/O解决方案，以确保性能、功耗和面积（PPA）的全面最优化。

台积电设计基础架构市场部高级总监李硕表示：“Artisan物理IP使台积电能够加速流片（tape-out）时间，从而以更快的速度将针对主流物联网和移动设备设计的尖端SoC推向市场。基于双方在28nmHPC+平台合作上的成功，台积电和Arm不断致力于在功耗和面积方面提供显著的优化，进而为双方的合作伙伴提供在更多设备上实现更优边缘计算体验的可能。”

三星多项目晶圆服务启动 将为中小企业提供8英寸代工服务

本报讯 三星电子宣布为其代工厂客户提供8英寸（200mm）技术解决方案，在其现有的eFlash之上，Power、显示驱动芯片（DDI）、CMOS图像传感器、RF/LOT和指纹技术解决方案现在可以通过三星8英寸的铸造服务获得。

目前，三星表示，客户与三星的合作十分紧密，在不同的领域利用三星先进的8英寸技术产品。所有的8英寸产品，包括从180nm到65nm范围内的产品，都在韩国的高度自动化工厂Line 6进行处理。

“考虑到8英寸解决方案的工业需求，客户的兴趣非常高。”三星电子的铸造营销副总裁Ryan Lee说：“随着我们将产品拓展到RF/IoT和指纹部分，我们将使我们的客户通过利用三星最先进的8英寸解决方案，在更广泛的应用范围内获益。”

三星的8英寸工艺技术产品现在包括以下解决方案：130nm、65nm的eFlash，130nm、90nm（BCD+eFlash）的Power，180nm、130nm、90nm、70nm的Display Driver IC，90nm的CMOS Image Sensor图像传感器，90nm（Ultra low leakage device）的RF/IoT，180nm的Fingerprint Sensor指纹传感器。

自去年5月三星代工厂（Samsung foundry）成为独立企业以来，8英寸的代工市场一直是焦点之一。在这方面，三星已经坚定地建立了以客户为中心的8英寸的服务能力，并拥有强大的多项目晶圆（MPW）程序和知识产权（IP），并于今年推出了三星先进的铸造生态系统（SAFETM）项目。

中星微电子集团产业集群落户青岛市北区

本报讯 日前，青岛市北区举行新旧动能转换招商推介暨重点项目签约会。市北区政府与中卫医疗健康服务产业基金、中星微电子集团产业集群、中国网络空间安全（青岛）产业园等涵盖金融保险、科技创新、总部经济领域的67个重点项目进行了集中签约。

据了解，市北区政府与中星微电子集团合作，着力发展新一代人工智能芯片及物联网产业集群项目。以邓中翰院士为首在市北区成立城市治理与智能化研究院，开展新一代人工智能神经网络处理器芯片的研发及安防监控物联网系统研发应用产业化项目，建设城市治理与智能化产业园区，推动青岛市智能产业壮大规模。

近年来中星微电子集团在人工智能、视频大数据等核心技术上取得了重大进展，量产了我国拥有自主知识产权的首款嵌入式神经网络处理器（NPU）——“星光智能一号”。最近，与公安部第一研究所联合牵头研究制定了专门针对安防监控特定技术要求、具有我国自主知识产权、达到国际领先水平的SVAC国家标准。目前，企业的研发团队已进驻市北区，中星微电子致力于数字多媒体行业芯片的研发，以技术为依托，使整个芯片产业集群落户市北区。

通富微电 已完成向大基金等转让公司股权

本报讯 5月8日，通富微电发布最新公告，公司收到富士通中国、产业基金、南通招商和道康信斌投资的通知，根据中国证券登记结算有限公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已办理完成，过户日期为2018年5月7日，股份性质为无限售流通股。

2月26日，通富微电子股份有限公司股东富士通（中国）有限公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司、南通招商江海产业发展基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区道康信斌投资合伙企业（有限合伙）分别签署了《股份转让合同》，富士通中国将其所持公司69547131股股份（占公司股份总数的6.03%）转让予受让方产业基金；将其所持公司57685229股股份（占公司股份总数的5%）转让予受让方南通招商；将其所持公司57685229股股份（占公司股份总数的5%）转让予受让方道康信斌投资。

产业基金是以促进我国集成电路产业发展为目的而设立的专业投资基金，通富微电在先进封装核心技术和关键工艺上拥有丰富的经验。通过本次权益变动，通富微电将加强与产业基金进一步的合作和联系。产业基金努力支持集成电路龙头企业发展，带动中国IC制造产业整体水平和国际竞争力的上升。

2018年上海新昇投资额将超过原计划

本报讯 5月7日，上海新阳半导体材料股份有限公司在投资者关系活动中披露了其参股子公司上海新昇大硅片项目的最新情况。上海新阳在这次活动中透露，按照大硅片项目的投资强度和投资规模，项目第一期的正常建设周期为3年，预计2018年底项目的月产能为10万片，2019年实现月产能20万片，2020年底实现月产能30万片。

韩国的拉晶炉设备较日本和德国的便宜，且订单交付有保障，从使用情况来看，韩国拉晶炉性能稳定，拉出的晶棒长达2m以上。而日本设备采购困难，德国设备贵且采购周期长。值得一提的是，上海新阳董秘杨靖曾向媒体透露，拉晶炉设备订购难是上海新昇的实际达产情况不及预期的主要因素之一。

在这次投资者活动中，上海新阳还提及，上海新昇大硅片项目截止2017年底投资小于18亿元，预计2018年的投资额将超过原计划月产能15万片所需要的投资额。

安森美半导体收购感测产品供应商SensL Technologies Ltd

本报讯 安森美半导体公司宣布收购SensL Technologies Ltd（以下简称“SensL”）。此次收购预计将立即增加安森美半导体的非公认会计原则（Non-GAAP）每股盈利。SensL总部位于爱尔兰，是专为汽车、医疗、工业和消费市场提供硅光电倍增管（SiPM）、单光子雪崩二极管（SPAD）和光达（LiDAR）感测产品的一个技术领导者。

收购使安森美半导体扩展其在先进驾驶辅助系统和自动驾驶的汽车感测应用领域的市场领导地位，拓阔在成像、雷达和光达的能力。

结合此次在爱尔兰的收购，及此前在以色列和英国收购的雷达技术和设计中心，安森美半导体具备独一无二的优势，为下一代高度自动化汽车提供全面的传感器方案，以及巩固公司在图像感测和超声波泊车辅助的领导地位。

图像传感器部高级副总裁兼总经理Taner Ozcelik说：“由Carl Jackson创立并由Bryan Campbell领导的整个SensL团队将SiPM推进市场做得有声有色，我们期待扩大他们在市场上的成功，并继续其LiDAR、医疗成像和辐射探测的产品组合。汽车传感器融合的需求正在加速增长，需求更多由SensL团队提供的传感器技术。”

意法半导体推出低功耗Sigfox与低功耗蓝牙BLE双功能无线IoT模块

本报讯 5月7日，半导体供应商意法半导体与中国台湾模块设计供应商佐臻股份有限公司（Jorjin Technologies Inc）于近日联合推出Sigfox和低功耗蓝牙（BLE）双功能无线模块。

采用了意法半导体的BlueNRG-1低功耗蓝牙（BLE）系统单芯片和S2-LP Sub-1GHz无线收发器的领先技术，佐臻WS211X系列Sigfox与低功耗蓝牙（BLE）双功能模块能够提供创新无线通信技术和强调节能的物联网应用。

佐臻推出的Sigfox模块内设意法半导体超低功耗平台，可独立支持系统运行。低功耗蓝牙（BLE）和Sigfox低功耗广域物联网（LP-WAN）的结合可同时在物联网系统内支持数种重要功能，例如，固件可透过低功耗蓝牙（BLE）下载（Over-the-air，OTA）进行更新，这个功能若是在仅支持Sigfox单模模块的状况下无法完成。

另外，利用Sigfox与低功耗蓝牙（BLE）双功能模块，Sigfox可以远距离连接及同时支持蓝牙低功耗（BLE）近距离传输，以达成联网设置安装及维修的诸多设定，或是针对如蓝牙Beacon定位等不同应用的结合，通过该模块进行资产追踪。